コンダクティブフォーム
CONDUCTIVE FOAM／XYT

A-JIN ELECTRON
A-JIN ELECTRON

導電フォームを使用した薄型タイプのシート型EMIガスケット
Thin EMI sheet gasket made with conductive foam

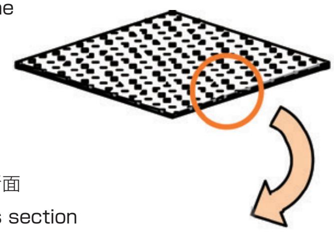
特　長 Feature

- モバイル機器や薄型モニターなど、省スペースが望まれる部位へのグランド対策に適しています
- 薄く且つクッション性に優れています
- スルーホール加工を施してあるため、カット・打ち抜き等様々な加工に対しても、上下間の導通が確保できます(粘着層には、導電粘着材を使用しています)

- Suitable solution for grounding for space saving areas such as mobile equipments, flat panel monitors etc.
- Thin and well cushioned foam gasket.
- Through hole process is provided. Conductivity between top and bottom surface is available. Custom profiles such as cutting, punching etc. are also available. (Conductive adhesive is used.)

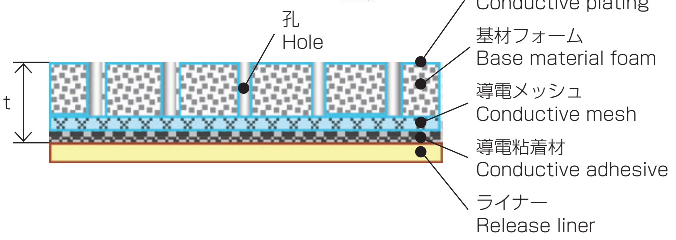
■ 製品外観

● Outline



■ 製品断面

● Cross section

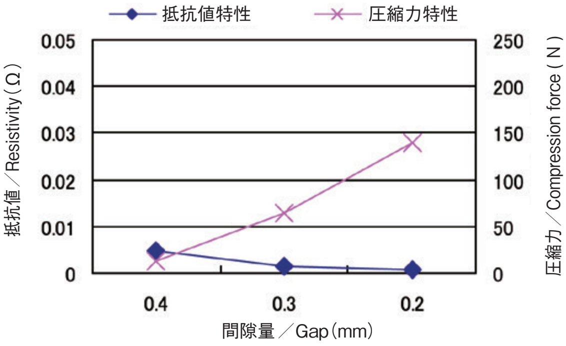


特性／Properties

■ 圧縮抵抗特性(XYT-0.5)

● Compression vs. Contact resistance (XYT-0.5)

サイズ:25×25mm
Size: 25 x 25 mm



品番／Part No.	XYT-0.3	XYT-0.5	XYT-0.7
基材材質／Base material	フォーム:オレフィン系フォーム／メッシュ:ポリエステル Foam: Olefinic foam / Mesh: Polyester		
めっき／Plating	Ni-Sn／Cuめっき Ni-Sn/Cu plating		
導電粘着層／Conductive adhesive	アクリル系導電粘着材 Acrylic conductive adhesive		
色／Color	Black		
t: 製品総厚／t: Total thickness (mm)	0.3	0.5	0.7
厚さ方向抵抗値(25mm2/1kg荷重) Resistivity in the thickness direction (25mm² / 1kg load)	＜ 0.1 Ω		
180˚剥離粘着力(25mm幅) Peel adhesion at 180˚(25mm width)	Min 1kgf		

※参考実測データ／保証値ではありません。
※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.